

2017年10月25日

会社名 : 株式会社ディスコ  
 代表者名 : 代表取締役社長 関家一馬  
 コード番号 : 6146 東証第一部  
 問い合わせ先 : 広報室 (03-4590-1090)

## 精密加工ツールの生産体制強化のため、桑畑工場の更なる拡張を決定

株式会社ディスコ（本社：東京都大田区、社長：関家一馬）は、約140億円を投資し、精密加工装置・精密加工ツールの製造を行う桑畑工場（広島県呉市）A棟に、現在建築中のCゾーンに加え、更にDゾーンを増築することを決定しました。

### Dゾーン増築の目的

<精密加工ツールの需要拡大へ対応するための生産体制増強>

IoTや自動運転技術などの進展を背景としたセンサ個数、データセンター設置数の増加など、半導体・電子部品の活用は今後も拡大が続くことが予想されます。それに伴い精密加工装置<sup>※1</sup>、及び精密加工ツール<sup>※2</sup>の需要も継続して拡大していくことが見込まれます。

このような市場環境に対し、精密加工装置の生産体制強化については、長野事業所 茅野工場の開設と、同工場へのマニュアルダイシングソーの生産ライン増設（2017年7月31日発表）を決定しています。

一方、精密加工ツールの需要増加については桑畑工場A棟Cゾーンの増築（2016年4月28日発表）にて対応を進めておりますが、この度、今後見込まれる需要増加に向けた、生産体制の更なる強化が必要であると判断し、Dゾーンの増築を決定いたしました。なお、Cゾーンに続けて増築工事をおこなうことで、総工費の削減も見込んでいます。

※1 精密加工装置：シリコンウェーハ等の切断・研削・研磨を行う機械

※2 精密加工ツール：精密加工装置に装着して切断・研削などの加工をおこなうツールで、頻りに交換される消耗品



桑畑工場 A 棟拡張イメージ

### 概要と建設計画

名称	桑畑工場 A 棟 D ゾーン
建屋構造	免震構造
延べ床面積	約 63,200 m <sup>2</sup> 参考 A ゾーン 約 62,800 m <sup>2</sup> B ゾーン 約 65,700 m <sup>2</sup> C ゾーン 約 65,700 m <sup>2</sup> (2018年12月竣工予定) ※ C、D ゾーンが完成すると、現状の約 2 倍の延べ床面積となります。
投資総額	約 140 億円
工期	(着工) 2019年9月～ (竣工) 2021年5月末

以上